

半導体パッケージとその材料の技術マーケティング

パナソニックインダストリー株式会社での募集です。 事業企画・事業開発のご経験の...

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
パナソニックインダストリー株式会社

求人ID
1610915

業種
電気・電子・半導体

雇用形態
正社員

勤務地
東京都 23区

給与
500万円 ~ 1000万円

勤務時間
08:30 ~ 17:00

休日・休暇
【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 GW 夏季...

更新日
2026年11月13日 02:00

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
ビジネス会話レベル

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2372863】
●担当業務と役割
電子材料の新商品企画及び技術開発を牽引し、市場投入のために関連部門と連携のうえ、総合的な戦略を立案～顧客（主にグローバル半導体メーカー）開発と折衝を行います。
・先端半導体パッケージ市場の10年先の変化を先読みし、開発ロードマップを策定と市場戦略の立案と実行
・材料レイヤーよりも上位の基板、実装プロセスなどの知見を用いた、顧客開発と材料開発、技術マーケティング活動
・顧客ニーズやトレンド分析に基づき、新商品のターゲットスペックや商品戦略策定
・開発・技術部門との連携による商品具現化、顧客との折衝、開発・販売戦略をグローバルに展開

●具体的な仕事内容
将来の有線系半導体デバイス、無線系半導体デバイスの進化・必要要件を調査し、そのパッケージ技術進化予測をもって、材料開発のテーマ化、開発部門連携の上 顧客折衝を行う。
・入社後に担当頂くアプリケーション分野を決定し、その分野の半導体デバイスのパッケージ形態を技術マーケティング、顧客との直接折衝を担当します。FAE業務も含みます。

●魅力
・AI開発が社会の進化をリードしている昨今、その進化を支える先端半導体パッケージ技術分野において、最先端の半導体技術を手掛けるグローバル企業とビジネスを通じてコネクト出来ます。
・世界の半導体市場を牽引するのマーケットリーダーとの直接対話を通じて、世界を変えるような新商品の創出に挑戦する事が出来ます。
・電子材料レイヤー視点から、地域、業界、市場といった広い視野を持って戦略を立案するなど、マーケターとしての自己成長の機会を得られます。

●キャリアパス
・半導体パッケージのマーケターとしてグローバルに自立
・本人の希望も踏まえ、海外拠点でのマーケティングおよび責任者としての赴任可能性
・力量を踏まえ、マーケティング上位職への登用も検討

スキル・資格

以下、メンバー ~ 管理職候補クラス共通です

【必須】
・半導体パッケージの開発経験を5年以上お持ちの方 (有機サブストレート基板開発、後工程の実装技術開発など)
・半導体パッケージ市場/ICメーカーとの対話力、新市場開拓、新商品開発の企画力をお持ちの方
・FAE (Field Application Engineering)、かつ商品認定活動経験をお持ちの方
・英語によるビジネスコミュニケーション
【歓迎】
・サブストレート基板、およびそのプロセスを熟知している方
・半導体パッケージ後工程の実装技術やプロセス知識、業界用語、サプライチェーンを熟知している方

会社説明

電気部品・電子部品・制御機器・電子材料等の開発・製造・販売